

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2023-063

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于首次公开发行部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行部分募集资金投资项目已建设完毕，经第二届董事会第二十二次会议批准，公司对首次公开发行募集资金投资项目之“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”予以结项，并将前述项目的节余募集资金（包含利息收益）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见，相关事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发行费用人民币 89,310,416.46 元后，募集资金净额为 915,187,611.29 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）于 2019 年 12 月 18 日将扣除保荐承销费后的募集资金合计 930,573,648.30 元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA15884 号”《验资报告》。前述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与保荐机构中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司分别于 2019 年 12 月 20

日、2021年11月13日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》及《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》)。

## 二、募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。根据《聚辰股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，相关募集资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	预计建设周期
以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	36,249.94	36,249.94	36个月
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	26,184.04	26,184.04	36个月
研发中心建设项目	10,315.07	10,315.07	36个月
<b>合计</b>	<b>72,749.05</b>	<b>72,749.05</b>	/

经2022年第一次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会批准，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额、内部投资结构以及预计建设周期做出调整，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见（详见公司分别于2022年1月28日和2022年9月29日披露的《聚辰股份关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的公告》、《聚辰股份关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的公告》）。调整后的募集资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	预计建设周期
以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	48,249.94	48,249.94	39个月
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	14,184.04	14,184.04	48个月
研发中心建设项目	10,315.07	10,315.07	39个月
<b>合计</b>	<b>72,749.05</b>	<b>72,749.05</b>	/

其中，“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“研

发中心建设项目”已于2023年3月达到预定可使用状态。经第二届董事会第十七次会议批准，公司于2023年4月28日对前述募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见（详见公司于2023年4月29日披露的《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

### 三、本次结项项目的募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已于2023年12月达到预定可使用状态，项目开发的音圈马达驱动芯片、RFID芯片以及微特电机驱动芯片等产品均已实现量产，取得了良好的经济效益和社会效益。截至本公告披露之日，公司“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额 (A)	累计投入募集资金总额 (B)	投入比例 (C=B/A)	利息收益扣除手续费后的净额 (D)	预计节余募集资金金额 (E=A-B+D)
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	14,184.04	13,357.47	94.17%	1,788.76	2,615.33

注：1、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；  
2、“利息收益扣除手续费后的净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

### 四、本次结项项目募集资金节余的主要原因

1、公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和《聚辰股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

2、在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在

确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## **五、节余募集资金的使用计划**

自首次公开发行股票并上市以来，公司持续加强对现有产品的完善与升级以及对新产品和新技术的研究与开发，研发投入占营业收入的比例逐年提升。截至2023年12月，公司“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。随着公司业务规模的扩张，为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益并降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金2,615.33万元永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金（含利息收益）转出完成后，公司将注销设立在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行的募集资金专户，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行以及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## **六、审议程序和专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

2023年12月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已于2023年12月建设完成并达到预定可使用状态，项目开发的各类产品均已实现量产，取得了良好的经济和社会效益。本次公司对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司主营业务发展，在提高募集资金使用效率的同

时，降低了企业财务费用，本次事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《聚辰股份募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### **（三）监事会审议情况**

2023年12月28日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司监事会认为，本次结项的“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已于2023年12月建设完成并达到预定可使用状态。公司将前述项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高公司经济效益，并降低了企业财务费用，符合公司和全体股东的利益，本次事项的内容和审议程序不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情形。

### **（四）保荐机构意见**

经核查，保荐机构中金公司认为：

聚辰股份本次首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见，已履行了必要的审批程序。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项无需提交聚辰股份股东大会审议。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2023年12月29日